

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2017-66269

(P2017-66269A)

(43) 公開日 平成29年4月6日(2017.4.6)

(51) Int.Cl.		F I		テーマコード (参考)
C O 9 D 201/00	(2006.01)	C O 9 D 201/00		4 J O 3 8
H O 1 B 1/22	(2006.01)	H O 1 B 1/22	A	5 G 3 0 1
H O 1 B 1/00	(2006.01)	H O 1 B 1/00	K	5 G 3 2 3
H O 1 B 13/00	(2006.01)	H O 1 B 13/00	5 O 3 Z	
C O 9 D 5/24	(2006.01)	C O 9 D 5/24		
審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 16 頁) 最終頁に続く				

(21) 出願番号	特願2015-193238 (P2015-193238)	(71) 出願人	506334182
(22) 出願日	平成27年9月30日 (2015.9.30)		DOWAエレクトロニクス株式会社
			東京都千代田区外神田四丁目14番1号
		(74) 代理人	100129470
			弁理士 小松 高
		(72) 発明者	藤田 英史
			東京都千代田区外神田四丁目14番1号
			DOWAエレクトロニクス株式会社内
		(72) 発明者	金田 秀治
			東京都千代田区外神田四丁目14番1号
			DOWAエレクトロニクス株式会社内
		(72) 発明者	伊東 大輔
			東京都千代田区外神田四丁目14番1号
			DOWAエレクトロニクス株式会社内
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 導電膜形成用塗料および導電膜の製造方法

(57) 【要約】

【課題】紙基材上に形成された銅の導電膜において、耐候性および導電性が顕著に改善されたものを提供する。

【解決手段】一次粒子の平均粒子径が10～100nmの微細銅粉Aと、レーザー回折・散乱法による体積基準の累積50%粒子径D₅₀が0.3～20.0μmの粗大銅粉Bと、同D₅₀が0.1～10.0μmの酸化銅(CuO)粉Cと、樹脂Dを含有する塗料であって、微細銅粉Aと粗大銅粉Bの合計量100質量部に対し、微細銅粉A：25～80質量部、酸化銅粉C：0.5～25質量部、樹脂D：3.0～8.0質量部の配合組成を有する塗料を用いて紙基材上に塗膜を形成し、光焼成および90～190℃での加熱プレスを行って導電膜とする。

【選択図】図1

